

TOC

Baking de componentes 2

Processo de soldadura 2

Limpeza de PCBs. 2

Other pages:

Baking de componentes

Baking de PCB a 100° durante >8 horas

Baking de BGA a 100° durante >24 horas

Processo de soldadura

Reflow das BGAs somente até 245°

Limpeza de PCBs

Lavar com alcool isopropílico abundantement os PCBs já montados

Lavar com despuma e líquido de limpeza

Comprar uma tina de ultrasons grande